



平成28年3月期 第1四半期決算短信〔日本基準〕(連結)

平成27年7月27日

上場会社名 東京エレクトロン デバイス株式会社 上場取引所 東  
 コード番号 2760 URL <http://www.teldevice.co.jp/>  
 代表者 (役職名) 代表取締役社長 (氏名) 徳重 敦之  
 問合せ先責任者 (役職名) 財務部長 (氏名) 田中 弘毅 (TEL) 045-443-4000  
 四半期報告書提出予定日 平成27年8月6日 配当支払開始予定日 —  
 四半期決算補足説明資料作成の有無 : 無  
 四半期決算説明会開催の有無 : 無

(百万円未満切捨て)

1. 平成28年3月期第1四半期の連結業績 (平成27年4月1日～平成27年6月30日)

(1) 連結経営成績(累計)

(%表示は、対前年同四半期増減率)

	売上高		営業利益		経常利益		親会社株主に帰属する四半期純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
28年3月期第1四半期	28,416	9.5	697	547.5	569	627.1	369	499.0
27年3月期第1四半期	25,949	20.0	107	△59.7	78	—	61	—

(注) 包括利益 28年3月期第1四半期 359百万円(689.1%) 27年3月期第1四半期 45百万円(△66.6%)

	1株当たり 四半期純利益	潜在株式調整後 1株当たり 四半期純利益
	円 銭	円 銭
28年3月期第1四半期	37.00	—
27年3月期第1四半期	6.19	—

(2) 連結財政状態

	総資産	純資産	自己資本比率
	百万円	百万円	%
28年3月期第1四半期	62,961	22,850	36.3
27年3月期	69,449	22,777	32.8

(参考) 自己資本 28年3月期第1四半期 22,850百万円 27年3月期 22,777百万円

2. 配当の状況

	年間配当金				
	第1四半期末	第2四半期末	第3四半期末	期末	合計
	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭	円 銭
27年3月期	—	30.00	—	30.00	60.00
28年3月期	—	—	—	—	—
28年3月期(予想)	—	30.00	—	30.00	60.00

(注) 直近に公表されている配当予想からの修正の有無 : 無

3. 平成28年3月期の連結業績予想 (平成27年4月1日～平成28年3月31日)

(%表示は、通期は対前期、四半期は対前年同四半期増減率)

	売上高		経常利益		親会社株主に帰属する当期純利益		1株当たり 当期純利益
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	円 銭
第2四半期(累計)	54,000	0.1	530	19.8	350	21.6	35.10
通期	114,000	2.1	1,600	17.8	1,050	46.4	105.31

(注) 直近に公表されている業績予想からの修正の有無 : 無

※ 注記事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 : 無

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 : 有

(注) 詳細は、添付資料3ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

① 会計基準等の改正に伴う会計方針の変更 : 有

② ①以外の会計方針の変更 : 無

③ 会計上の見積りの変更 : 無

④ 修正再表示 : 無

(注) 詳細は、添付資料3ページ「サマリー情報（注記事項）に関する事項」をご覧ください。

(4) 発行済株式数（普通株式）

① 期末発行済株式数（自己株式を含む）

28年3月期1Q	10,445,500株	27年3月期	10,445,500株
28年3月期1Q	456,484株	27年3月期	474,800株
28年3月期1Q	9,978,939株	27年3月期1Q	9,964,000株

② 期末自己株式数

③ 期中平均株式数（四半期累計）

(注) 当社は、役員報酬BIP信託及び従業員持株ESOP信託を導入しており、各信託が所有する当社株式は自己株式に含めて記載しております。

※ 四半期レビュー手続の実施状況に関する表示

この四半期決算短信は、金融商品取引法に基づく四半期レビュー手続の対象外であり、この四半期決算短信の開示時点において、四半期連結財務諸表に対する四半期レビュー手続は終了していません。

※ 業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項

本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報及び合理的であると判断する一定の前提に基づいており、その達成を当社として約束する趣旨のものではありません。また、実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想に関する事項等については、添付資料2ページ「連結業績予想などの将来予測情報に関する説明」をご覧ください。

## ○添付資料の目次

1. 当四半期決算に関する定性的情報 .....	2
(1) 経営成績に関する説明 .....	2
(2) 財政状態に関する説明 .....	2
(3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明 .....	2
2. サマリー情報(注記事項)に関する事項 .....	3
(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動 .....	3
(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用 .....	3
(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示 .....	3
3. 四半期連結財務諸表 .....	4
(1) 四半期連結貸借対照表 .....	4
(2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書 .....	5
(3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書 .....	7
(4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項 .....	8
(継続企業の前提に関する注記) .....	8
(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記) .....	8
(セグメント情報) .....	8
4. 補足情報 .....	9
(1) 仕入、受注及び販売の状況 .....	9

## 1. 当四半期決算に関する定性的情報

### (1) 経営成績に関する説明

当第1四半期連結累計期間におけるわが国経済は、企業収益が総じて改善し、雇用・所得環境改善の兆しがうかがわれるなど、緩やかな回復基調で推移しております。また、中国をはじめとしたアジア地域に一部弱さがみられるものの、米国における内需拡大等に支えられ、世界経済についても緩やかな回復を示しております。

当社グループにおける当第1四半期連結累計期間の業績については、売上高284億1千6百万円（前年同期比9.5%増）、売上高の増加等に伴い、営業利益6億9千7百万円（前年同期比547.5%増）、経常利益5億6千9百万円（前年同期比627.1%増）、親会社株主に帰属する四半期純利益3億6千9百万円（前年同期比499.0%増）となりました。

報告セグメントに係る業績については、次のとおりであります。

#### （半導体及び電子デバイス事業）

半導体メーカーの再編が進む中、半導体需要は産業機器向けに一部陰りがみられるものの、自動車に搭載される電子デバイスの増加等により、引き続き堅調に推移しております。

このような状況のもと、販売代理店契約の解消に伴いカスタムICの売上高が減少いたしました。国内のほか、中国及び東南アジア地域において情報端末向けにアナログICやプロセッサが好調に推移したことに加え、車載向けにアナログICが伸長したことなどから、当第1四半期連結累計期間における売上高は242億3千5百万円（前年同期比6.8%増）、売上高増加等により、セグメント利益（経常利益）は3億7千3百万円（前年同期比384.5%増）となりました。

#### （コンピュータシステム関連事業）

企業収益の改善等を背景として、凍結していたシステム案件の再開及び国内生産拠点の強化などから、企業のITへの投資意欲は高まっております。また、「マイナンバー制度」への準備対応等新たなIT投資の需要が見受けられます。

このような状況のもと、官公庁向けにネットワーク機器及びストレージ機器の販売が好調に推移したことなどから、当第1四半期連結累計期間における売上高は41億8千1百万円（前年同期比28.0%増）、製品販売が回復したことなどにより、セグメント利益（経常利益）は1億9千5百万円（前年同期はセグメント利益1百万円）となりました。

### (2) 財政状態に関する説明

当第1四半期連結会計期間末における総資産は629億6千1百万円となり、前連結会計年度末に比べ64億8千8百万円の減少となりました。これは主に、受取手形及び売掛金並びに商品及び製品が減少したことによります。負債総額は401億1千万円となり、前連結会計年度末に比べ65億6千1百万円の減少となりました。これは主に、買掛金及び短期借入金が増加したことによります。また、純資産総額は228億5千万円となり、前連結会計年度末に比べ7千2百万円の増加となりました。以上の結果、自己資本比率は36.3%となり前連結会計年度末に比べ3.5ポイント向上いたしました。

### (3) 連結業績予想などの将来予測情報に関する説明

当第1四半期連結累計期間の業績については、当初の見通しに対し好調な推移となっておりますが、商権移管をはじめとした外部環境の変化等を勘案した結果、前回（平成27年4月24日）公表の第2四半期連結累計期間及び通期連結業績予想は修正しておりません。

2. サマリー情報(注記事項)に関する事項

(1) 当四半期連結累計期間における重要な子会社の異動

該当事項はありません。

(2) 四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用

税金費用については、当連結会計年度の税引前当期純利益に対する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前四半期純損益に当該見積実効税率を乗じて計算しております。

(3) 会計方針の変更・会計上の見積りの変更・修正再表示

(会計方針の変更)

「企業結合に関する会計基準」(企業会計基準第21号 平成25年9月13日)、「連結財務諸表に関する会計基準」(企業会計基準第22号 平成25年9月13日)及び「事業分離等に関する会計基準」(企業会計基準第7号 平成25年9月13日)等を、当第1四半期連結会計期間から適用し、四半期純利益等の表示の変更及び少数株主持分から非支配株主持分への表示の変更を行っております。当該表示の変更を反映させるため、前第1四半期連結累計期間及び前連結会計年度については、四半期連結財務諸表及び連結財務諸表の組替えを行っております。

## 3. 四半期連結財務諸表

## (1) 四半期連結貸借対照表

(単位：百万円)

	前連結会計年度 (平成27年3月31日)	当第1四半期連結会計期間 (平成27年6月30日)
<b>資産の部</b>		
流動資産		
現金及び預金	2,302	1,757
受取手形及び売掛金	28,160	25,635
電子記録債権	700	646
商品及び製品	24,981	21,405
仕掛品	36	111
その他	7,434	7,748
流動資産合計	63,615	57,306
固定資産		
有形固定資産	902	877
無形固定資産	1,099	1,018
投資その他の資産		
退職給付に係る資産	964	977
その他	2,877	2,792
貸倒引当金	△10	△10
投資その他の資産合計	3,831	3,759
固定資産合計	5,833	5,655
資産合計	69,449	62,961
<b>負債の部</b>		
流動負債		
買掛金	9,673	6,906
短期借入金	16,418	12,614
1年内返済予定の長期借入金	96	96
賞与引当金	738	303
その他	6,872	7,566
流動負債合計	33,799	27,486
固定負債		
長期借入金	5,384	5,360
退職給付に係る負債	6,768	6,714
その他	720	549
固定負債合計	12,872	12,624
負債合計	46,671	40,110
<b>純資産の部</b>		
株主資本		
資本金	2,495	2,495
資本剰余金	5,645	5,645
利益剰余金	14,618	14,674
自己株式	△703	△676
株主資本合計	22,056	22,138
その他の包括利益累計額		
その他有価証券評価差額金	5	-
繰延ヘッジ損益	△36	△21
為替換算調整勘定	366	381
退職給付に係る調整累計額	386	351
その他の包括利益累計額合計	721	711
純資産合計	22,777	22,850
負債純資産合計	69,449	62,961

## (2) 四半期連結損益計算書及び四半期連結包括利益計算書

## 四半期連結損益計算書

第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月 1日 至 平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年6月30日)
売上高	25,949	28,416
売上原価	22,554	24,350
売上総利益	3,394	4,065
販売費及び一般管理費		
給料及び手当	1,459	1,450
賞与引当金繰入額	166	292
退職給付費用	139	130
その他	1,521	1,494
販売費及び一般管理費合計	3,287	3,368
営業利益	107	697
営業外収益		
受取保険金	-	23
その他	4	8
営業外収益合計	4	32
営業外費用		
為替差損	3	127
その他	30	33
営業外費用合計	34	160
経常利益	78	569
特別利益		
関係会社出資金売却益	-	8
特別利益合計	-	8
特別損失		
固定資産除却損	0	2
投資有価証券売却損	-	9
特別損失合計	0	11
税金等調整前四半期純利益	78	566
法人税等	16	196
四半期純利益	61	369
親会社株主に帰属する四半期純利益	61	369

四半期連結包括利益計算書  
第1四半期連結累計期間

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月 1日 至 平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年6月30日)
四半期純利益	61	369
その他の包括利益		
その他有価証券評価差額金	△0	△5
繰延ヘッジ損益	29	14
為替換算調整勘定	△19	31
退職給付に係る調整額	△29	△35
持分法適用会社に対する持分相当額	3	△16
その他の包括利益合計	△16	△10
四半期包括利益	45	359
(内訳)		
親会社株主に係る四半期包括利益	45	359
非支配株主に係る四半期包括利益	-	-



## (3) 四半期連結キャッシュ・フロー計算書

(単位：百万円)

	前第1四半期連結累計期間 (自 平成26年4月 1日 至 平成26年6月30日)	当第1四半期連結累計期間 (自 平成27年4月 1日 至 平成27年6月30日)
<b>営業活動によるキャッシュ・フロー</b>		
税金等調整前四半期純利益	78	566
減価償却費	118	118
のれん償却額	25	25
賞与引当金の増減額 (△は減少)	△202	△436
退職給付に係る負債の増減額 (△は減少)	49	△61
支払利息	13	18
投資有価証券売却損益 (△は益)	-	9
関係会社出資金売却損益 (△は益)	-	△8
売上債権の増減額 (△は増加)	△125	2,667
たな卸資産の増減額 (△は増加)	△1,757	3,605
仕入債務の増減額 (△は減少)	△159	△2,782
未払金の増減額 (△は減少)	199	△452
前受金の増減額 (△は減少)	882	1,318
未消費税等の増減額 (△は増加)	1,104	2,972
未収入金の増減額 (△は増加)	761	△3,036
その他	△304	△254
小計	683	4,268
利息及び配当金の受取額	0	0
利息の支払額	△14	△19
法人税等の支払額	△204	△566
営業活動によるキャッシュ・フロー	464	3,682
<b>投資活動によるキャッシュ・フロー</b>		
有形固定資産の取得による支出	△14	△5
無形固定資産の取得による支出	△34	△37
その他	43	1
投資活動によるキャッシュ・フロー	△5	△41
<b>財務活動によるキャッシュ・フロー</b>		
短期借入金の純増減額 (△は減少)	779	△3,901
長期借入金の返済による支出	-	△24
自己株式の取得による支出	△859	-
自己株式の処分による収入	-	28
配当金の支払額	△318	△299
その他	△0	△0
財務活動によるキャッシュ・フロー	△399	△4,195
現金及び現金同等物に係る換算差額	△5	10
現金及び現金同等物の増減額 (△は減少)	54	△544
現金及び現金同等物の期首残高	1,285	2,302
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額	14	-
現金及び現金同等物の四半期末残高	1,355	1,757

## (4) 四半期連結財務諸表に関する注記事項

(継続企業の前提に関する注記)

該当事項はありません。

(株主資本の金額に著しい変動があった場合の注記)

該当事項はありません。

(セグメント情報)

## I 前第1四半期連結累計期間(自 平成26年4月1日 至 平成26年6月30日)

## 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	22,683	3,265	25,949	—	25,949
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	22,683	3,265	25,949	—	25,949
セグメント利益	77	1	78	—	78

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

## II 当第1四半期連結累計期間(自 平成27年4月1日 至 平成27年6月30日)

## 1. 報告セグメントごとの売上高及び利益又は損失の金額に関する情報

(単位：百万円)

	報告セグメント			調整額	四半期連結損益 計算書計上額 (注)
	半導体及び 電子デバイス 事業	コンピュータ システム関連 事業	計		
売上高					
外部顧客への売上高	24,235	4,181	28,416	—	28,416
セグメント間の内部売上高 又は振替高	—	—	—	—	—
計	24,235	4,181	28,416	—	28,416
セグメント利益	373	195	569	—	569

(注) セグメント利益の合計額は、四半期連結損益計算書の経常利益と一致しております。

## 4. 補足情報

## (1) 仕入、受注及び販売の状況

## ① 仕入実績

当第1四半期連結累計期間における仕入実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	仕入高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	18,020	△17.8
コンピュータシステム関連事業	2,829	21.4
合計	20,850	△14.0

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## ② 受注実績

当第1四半期連結累計期間における受注実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	受注高 (百万円)	前年同四半期比 (%)	受注残高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	24,031	△2.4	14,302	6.7
コンピュータシステム関連事業	4,840	25.8	7,639	17.7
合計	28,871	1.4	21,941	10.3

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

## ③ 販売実績

当第1四半期連結累計期間における販売実績をセグメントごとに示すと、次のとおりであります。

セグメントの名称	販売高 (百万円)	前年同四半期比 (%)
半導体及び電子デバイス事業	24,235	6.8
コンピュータシステム関連事業	4,181	28.0
合計	28,416	9.5

(注) 上記の金額には、消費税等は含まれておりません。